

## 天津金海通半导体设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、本次申请综合授信额度的基本情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展规划和战略实施的需要，拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 25,000 万元（包括 25,000 万元）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。在上述额度在有效期内可以循环使用，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会、股东大会。股东大会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、包含融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月。

公司以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保，具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

公司实际控制人崔学峰先生、龙波先生及其他公司股东等关联自然人及法人拟根据实际需要为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保、反担保，具体担保、反担保的金额及期限以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的授信协议、借款协议、担保协议为准，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

### 二、担保方基本情况

崔学峰先生、龙波先生为公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，崔学峰先生、龙波先生不属于失信被执行人。

### 三、相关决策程序

公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023年11月29日